



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23098X

Issue Date: 01 Apr 2020

Title of Change:	Replace Ag plated lead frame with Cu plated lead frame for SC88 parts at Leshan, China		
Proposed First Ship date:	01 Aug 2020 or earlier if approved by customer		
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or York.Yu@onsemi.com		
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.		
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>		
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Products (listed on this PCN) assembled with the Cu plated lead frame in ON Semiconductor facility, Leshan, China, will have a Finish Good Date Code from about Week 28, 2020 or greater		
Change Category:	Assembly Change		
Change Sub-Category(s):	Material Change		
Sites Affected:			
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites	
Leshan Phoenix Semiconductor, China		None	
Description and Purpose:			
	Before Change Description	After Change Description	
Lead Frame	Ag plated lead frame	Cu plated lead frame	
Reliability Qualification and electrical characterization will be performed during qualification, and can be shared after issuing Final PCN.			
Qualification Plan:			
QV device name: NVJS3151PT1G & NVJD4152PT1G			
RMS#: 65482 & 67237			
Package: SC88			
Test	Specification	Condition	Interval
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-
Estimated date for qualification completion: 3 July 2020			

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NSTJS3157NT1G	NA
NTJD1155LT2G	NA
NTJD4152PT1H	NA
NTJS4405NT1H	NA
NSL12AWT1G	NA
NSS12200WT1G	NA
NTJD1155LT1G	NA
NTJD4152PT1G	NA
NTJD4152PT2G	NA
NTJD4158CT1G	NA
NTJD5121NT1G	NA
NTJD5121NT2G	NA
NTJS3151PT1G	NA
NTJS3151PT2G	NA
NTJS4405NT1G	NA

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23098X

発行日: 01 Apr 2020

変更件名:	楽山(中国)における SC88 製品のリードフレームを銀メッキから銅メッキに変更		
初回出荷予定日:	01 Aug 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前		
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <York.Yu@onsemi.com> にお問い合わせください。		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。		
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。		
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	オン・セミコンダクター楽山工場(中国)において銅メッキリードフレームを用いて組み立てられる製品(本 PCN に記載)には、2020 年第 28 週以降の完成品日付コードが付与されます。		
変更カテゴリ:	アセンブリの変更		
変更サブカテゴリ:	材料の変更		
影響を受ける拠点:			
オン・セミコンダクター拠点:		外部製造工場 / 下請業者拠点:	
Leshan Phoenix Semiconductor, China		なし	
説明および目的:			
	変更前の表記	変更後の表記	
リードフレーム	Ag plated lead frame	Cu plated lead frame	
信頼性認定試験と電気的特性評価は認定時に実施され、最終製品変更通知が発行された後に提供可能です。			
認定計画:			
デバイス名: NVJS3151PT1G & NVJD4152PT1G RMS: 65482 & 67237 パッケージ: SC88			
テスト	規格	条件	間隔
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-
認定完了予定日: 3 July 2020			



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23098X

発行日: 01 Apr 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NSTJS3157NT1G	NA
NTJD1155LT2G	NA
NTJD4152PT1H	NA
NTJS4405NT1H	NA
NSL12AWT1G	NA
NSS12200WT1G	NA
NTJD1155LT1G	NA
NTJD4152PT1G	NA
NTJD4152PT2G	NA
NTJD4158CT1G	NA
NTJD5121NT1G	NA
NTJD5121NT2G	NA
NTJS3151PT1G	NA
NTJS3151PT2G	NA
NTJS4405NT1G	NA